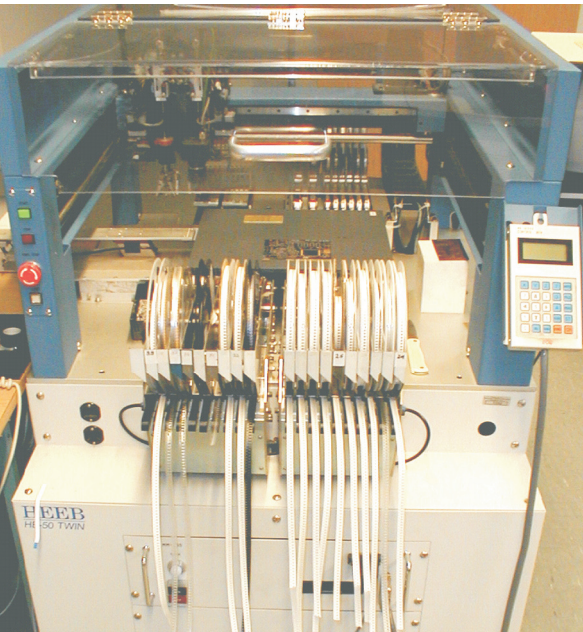


# Labor für elektrische Baugruppen und Mechatronik



SMD- Bestückungsautomat HE 50 Twin

## Leiter

Prof. Dr. rer. nat. Frank Köster

Prof. Dr.-Ing. Peter Hübner

## Mitarbeiter

Dipl.-Ing. Eckhard Drechsel

## Allgemein

Montage- und Verbindungstechnik von elektrischen, elektronischen und mechanischen Baugruppen

## Ausstattung

- SMD-Bestückungsautomat HE 50 Twin (HEEB GmbH)
  - Bestückung von Bauelementeträgern mit aufsetzbaren Bauelementen
  - Nutzformat max. 380 mm x 315 mm
  - bestückbare Bauformen 0805 bis PLCC44
- Reflow -Lötöfen HR 240/15
- Lötén der SMD -Bauelemente, Aushärten von Klebstoff;
  - Arbeitsbreite 240 mm
- Schwallötmaschine HWL 240
  - Schwallötén der Bauelemente
  - Arbeitsbreite 240 mm
- Schablonendrucker (Eigenbau)
  - Druck von Lotpaste und Kleber
  - Druckbereich (150 - 200) mm
- Manueller Drahtbonder MDB 10
  - zur Verbindung der Kontaktflächen von Halbleiterbauelementen mit den Anschlüssen der verschiedensten Bauelementeträger durch Ziehen von Drahtbrücken mittels Ultraschall - Schweißverfahren
  - Draht: Aluminium und Al - Legierungen
  - Drahtdurchmesser (25-50)  $\mu\text{m}$

## Nutzbar

- Bestückung von Bauelementeträgern mit aufsetzbaren Bauelementen, Nutzformat max. 380 x 315 mm (bestückbare Bauformen 0805- PLCC 44
- Lötén der SMD - Bauelemente, Aushärten von Klebstoff (Arbeitsbreite 240 mm)
- Schwallötén (Arbeitsbreite 240 mm)
- Ultraschallbonden

## Kontaktadresse

Hochschule Mittweida  
Fakultät Maschinenbau  
Technikumplatz 17  
09648 Mittweida

Tel.: 03727 / 58 15 32 od. 58 14 60  
Fax: 03727 / 58 13 76  
koester@hs-mittweida.de,  
huebner2@hs-mittweida.de